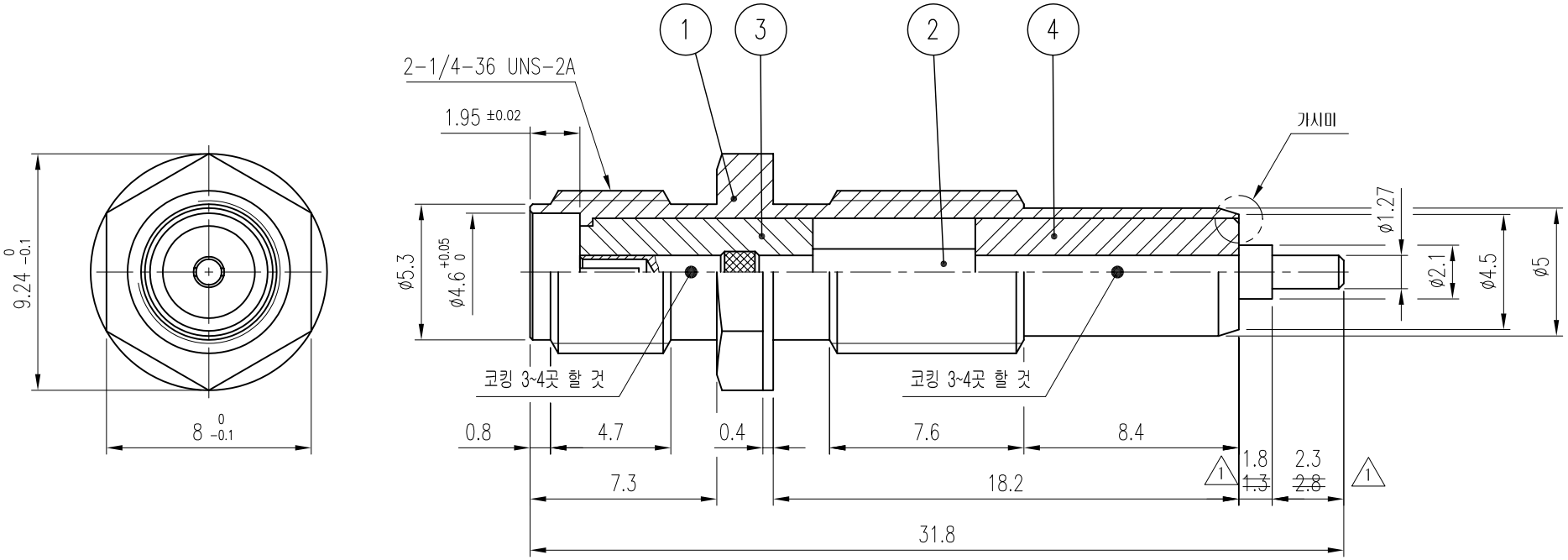
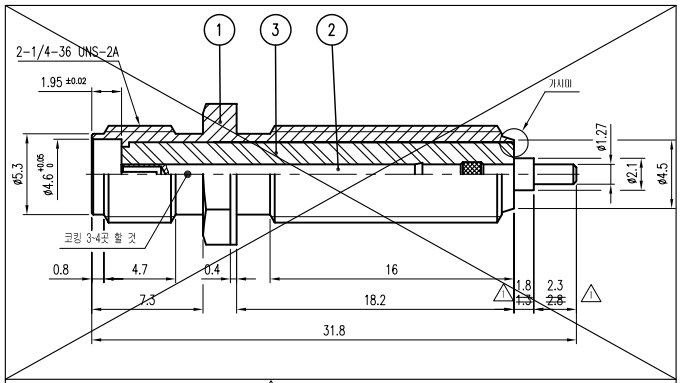
가공 / ST										
ST(기존)										
ST(개선)										

수 정 내 용

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
1	[설변NO. 연구2007-067] 신뢰성 향상		윤상진	2007. 04. 03.
2	[설변NO. 연구2007-118] 조립성 향상	최유나	윤상진	2007. 07. 05.





2 설변 전 VER.1

	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
2	4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01121-N/1 (H2380)
2	3	INSULATOR	1	TEFLON		~~H2347~~ DIN00230-N/1 (H2323)
2 1	2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT01309-5/1 (E2552)
2	1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	~~D2497~~ DBD01684-5/1(D2548)

대체가능재질

공통공차
.* ±0.1
.** ±0.05

재질

열처리

보호피막처리

년월일 2007. 3. 19.

승인

검도

제도

직성부서 연 구 소

척도 4/1 단위 mm 중량 —

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 SMA-J-NUT VER.2

A4

도번 CN01119-7/1

K314-512-401